

展示エリア出展企業・団体

■企業・団体（申し込み順）

- リソテックジャパン株式会社 (<https://www.ltj.co.jp/>)
「 未定 」
- MI-6 株式会社 (<https://mi-6.co.jp/>)
「 AI と研究者の知見を融合し、研究開発を加速させる「次世代の開発スタイル」 」
- ファインネクス株式会社 (<https://www.finecs.co.jp/>)
「 Cu Pillar Pin 及びパワー半導体用スリープ端子 」
- ミタニマイクロニクス株式会社 (<https://mitani-micro.co.jp/>)
「 フォトマスク、スクリーンマスク 」
- HORIBA （株式会社堀場製作所） (<https://www.horiba.com/jp/>)
（株式会社堀場エステック） (<https://www.horiba.com/jpn/semiconductor/about-us/stec/>)
「 未定 」
- 株式会社栄電子 (<https://sakae-denshi.com/>)
「 BAL SEAL 製品のご照会(仮称) 」
- ジェイエムテクノロジー株式会社 (<http://jmtech.com/>)
「 業務自動化ソリューション【ロボオペレータ】(予定) 」
- 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (<https://www.screen.co.jp/spe/>) 2 ブース
「 SCREEN の半導体製造装置およびソリューション 」
- 奥野製薬工業株式会社 (<http://www.okuno.co.jp/>)
「 ・セラミック基板上焼結導体回路への無電解めっきプロセス
・ガラス基板へのトータルめっきプロセス 」
- 株式会社村田製作所 (<https://www.murata.com/ja-jp>)
「 排気循環濃縮装置 」
- ローム株式会社 (<https://www.rohm.co.jp/>)
「 エンドポイント AI チップ”Solist-AI™”による機械設備等の異常の予兆検知 」
- 株式会社東設 (<https://www.tosetz.com/>)
「 ①脱気システム ②電解めっき 」

■大学関係：テーマ「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)の取組」 3 ブース

- 京都大学(ナノハブ拠点) (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)
- 大阪大学 (<https://www.osaka-u.ac.jp/ja>)
- 奈良先端科学技術大学院大学 (<http://www.naist.jp/>)
- 山形大学 (<https://yamagata-u.ac.jp>)
- 京都大学(ARIM 運営機構) (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)